



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100730002  
2011 年 2 月 2 日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタマドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

### HPA/PWR 18 ピンPDIPパッケージ 一部製品 組立サイト追加のご案内

(初版 PCN20100730002 2010 年 8 月 20 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HPA/PWR 18ピンPDIPパッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行 : UTAC2社(タイ) 変更後 : UTAC2社(タイ), MMT社(タイ)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	3月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) 18ピンPDIPパッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 UTAC2社(タイ)サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、MMT社(タイ)サイトを追加し認定しました。また、部材の変更は下記のようになります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	UTAC2社(タイ)	UTAC2社(タイ) MMT社(タイ)

	現行	追加認定
組立サイト	UTAC2	MMT
チップ接着剤	PZ0013	142010001
モールド樹脂	CZ0096	141002084
リードフレーム (端子処理, 部材)	NiPdAu, Cu	NiPdAuAg, Cu

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
ADS1210P	UC2526NG4	UC2874N-1	UC3526NG4	UC3874N-1
ADS1210PG4	UC2544N	UC2874N-1G4	UC3544N	UC3874N-1G4
ADS1212P	UC2544NG4	UC2874N-2	UC3544NG4	UC3874N-2
ADS1212PG4	UC2637N	UC2874N-2G4	UC3637N	UC3874N-2G4
DAC7541AJP	UC2637NG4	UC2903N	UC3637NG4	UC3903N
DAC7541AJPG4	UC2841N	UC2903NG4	UC3841N	UC3903NG4
DAC7541AKP	UC2841NG4	UC2914N	UC3841NG4	UC3914N
DAC7541AKPG4	UC2851N	UC2914NG4	UC3851N	UC3914NG4
UC2526AN	UC2851NG4	UC3526AN	UC3851NG4	
UC2526ANG4	UC2871N	UC3526ANG4	UC3871N	
UC2526N	UC2871NG4	UC3526N	UC3871NG4	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L, 23L)が下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	UTAC2	ASO: NS2	ACO: THA
追加認定	MMT	ASO: ALP	ACO: THA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年1月26日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1210P	Die Sizes (mm):	3.63 X 6.3	
Assembly Site:	ALP - MMT	Package/Code/Pins:	PDIP/N/18	
Mount Compound:	142010001	Mold Compound:	141002084	
Bond Wire:	1.3 MIL Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 300 Hours	77/0	77/0	77/0
Electrical Characterization	-	10/0	6/0	7/0
High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hours	77/0	77/0	77/0
Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved	Approved	Approved
Lead Pull	# of leads to destruction	22/0	-	-
Lead Fatigue	# of leads	10/0	-	-
Lead Finish Adhesion	# of leads	10/0	-	-
Manufacturability, Assembly	Per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	Top side only	5/0	5/0	5/0

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年1月26日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	UC3637N	Die Sizes (mm):	2.44 X 2.24	
Assembly Site:	ALP - MMT	Package/Code/Pins:	PDIP/N/18	
Mount Compound:	142010001	Mold Compound:	141002084	
Bond Wire:	1.3 MIL Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
Manufacturability, Assembly	Per mfg. Site specification	Approved		
X-ray	Top side only	5/0		
T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0		

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004年5月11日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2803AN	Die Sizes (mm):	3.04 X 1.74	
Assembly Site:	ALP - MMT	Package/Code/Pins:	PDIP/N/18	
Mount Compound:	142010001	Mold Compound:	141002046	
Bond Wire:	1.0 MIL Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Visual / Mechanical	-	Approved	Approved	Approved
Bond Strength	76 ball bonds	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	11/0	11/0	11/0
Manufacturability, Assembly	Per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	Top side only	5/0	5/0	5/0
Solderability	-	22/0	22/0	22/0